

IE-PCB-SPM-P-180-SMD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



SPElink®



シングルペアイーサネット PCB ソケット

シングルペアイーサネットは、データと電力を伝送するために必要な配線ペアが 1 つだけの技術です。その結果、SPEはフィールドレベル以上のネットワークとして推奨されるようになることが期待されます。シングルペアイーサネット（SPE）の利点は次の通りです：

- 整合性：シングルペアイーサネット（SPE）により、センサーからクラウドへのラウドまでイーサネットベースの統一された通信を実現
- 将来性：インダストリー4.0とIIoTのためのキーテクノロジー
- 柔軟性：最大1000mまでの距離と最大1Gbpsの伝送特性により、あらゆるアプリケーションで適用可能
- 革新的：軽量化、省スペース化、設置工数の削減。

一般注文データ

バージョン	組み込み型プラグ, M8 PCBインサート, IP67 (ハウジングあり), SMDはんだ接続, 180°, 極数: 2
注文番号	2795110000
種別	IE-PCB-SPM-P-180-SMD
GTIN (EAN)	4064675119166
数量	100 Stück

IE-PCB-SPM-P-180-SMD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技術データ

寸法と重量

深さ	14.5 mm	奥行き (インチ)	0.571 inch
高さ	22.1 mm	高さ (インチ)	0.87 inch
幅	10.1 mm	幅 (インチ)	0.398 inch
正味重量	5.14 g		

温度

動作温度	-40 °C...85 °C
------	----------------

システム仕様

PCB の取り付け	SMDはんだ接続	はんだ付け工程	リフローハンダ付け, 手動 はんだ付け
カテゴリー	T1-B	プラグイン回数	≥ 100
保護度合い	IP67 (ハウジングあり)	外向きエルボ	180°
性能カテゴリ	T1-B	極数	2
製品ファミリー	産業用イーサネット		

標準

コネクタ規格	IEC 63171-5
--------	-------------

電気プロパティ

定格電圧	72 V	定格電流	4 A
絶縁耐性	≥ 500 MΩ		

材料データ

絶縁材	LCP	色	黒色
カラーチャート (類似)	RAL 9011	絶縁耐性	≥ 500 MΩ
Moisture Level (MSL)	1	UL 94 可燃性等級	V-0
接点材質	銅合金	接触表面	Ni/Au
動作温度、最小	-40 °C	動作温度、最大	85 °C

梱包

VPE 長	327 mm	VPE幅	327 mm
VPEの高さ	52 mm		

分類

ETIM 6.0	EC002637	ETIM 7.0	EC002637
ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ECLASS 9.0	27-44-04-02	ECLASS 9.1	27-44-04-02
ECLASS 10.0	27-44-04-02	ECLASS 11.0	27-46-02-01
ECLASS 12.0	27-46-02-01	ECLASS 13.0	27-46-02-01

環境製品コンプライアンス

REACH SVHC	/
------------	---

作成日 2024/07/02 5:52:22 CEST

IE-PCB-SPM-P-180-SMD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術データ

承認

ROHS

適合

ダウンロード

エンジニアリングデータ

[CAD data – STEP](#)

技術文書

[IE-PCB-SPM-P-180-SMD](#)

カタログ

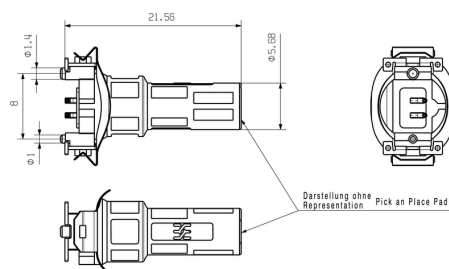
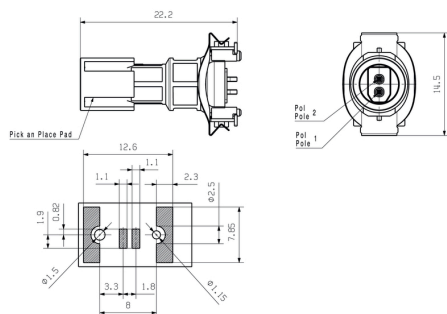
[Catalogues in PDF-format](#)

IE-PCB-SPM-P-180-SMD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

図面



Recommended reflow soldering profile

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

- Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically $\leq +3\text{K/s}$. In parallel the solder paste is 'activated'. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at $\geq -6\text{K/s}$ solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.